

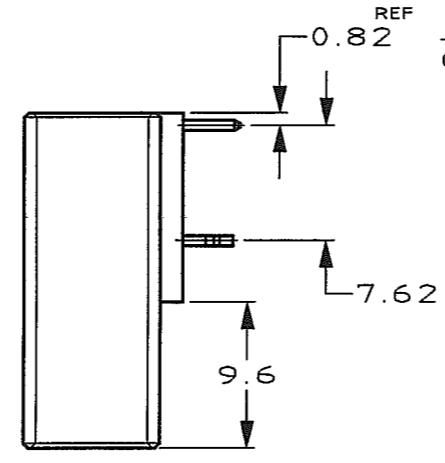
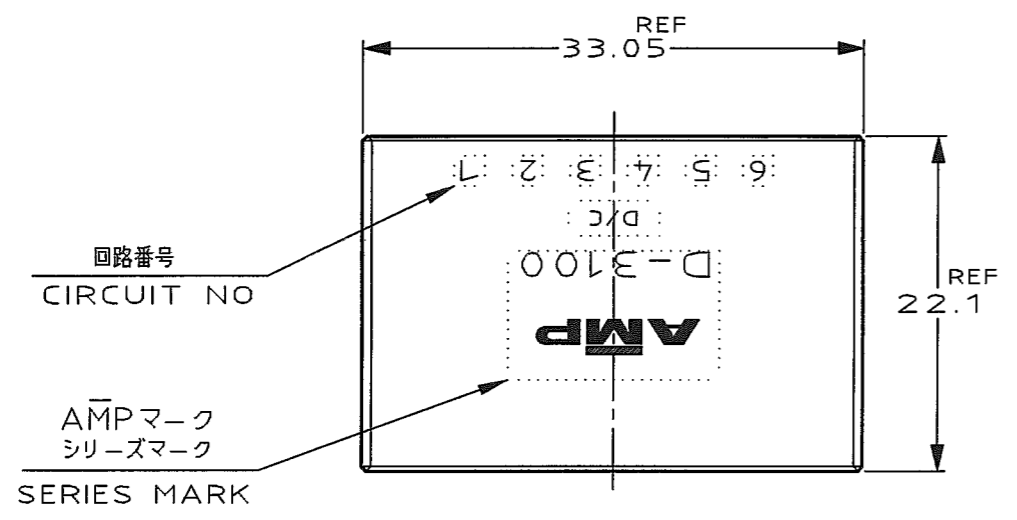
NUMBER 178296



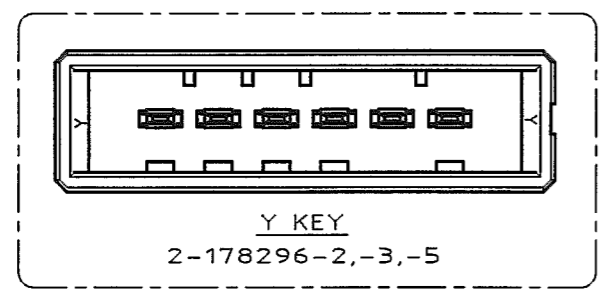
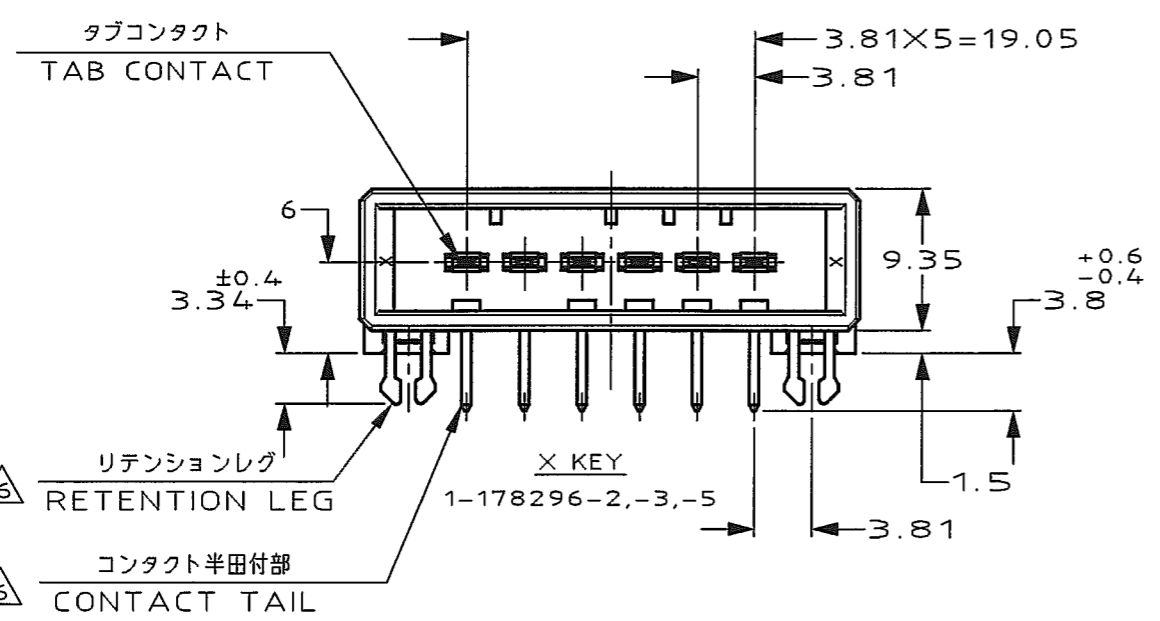
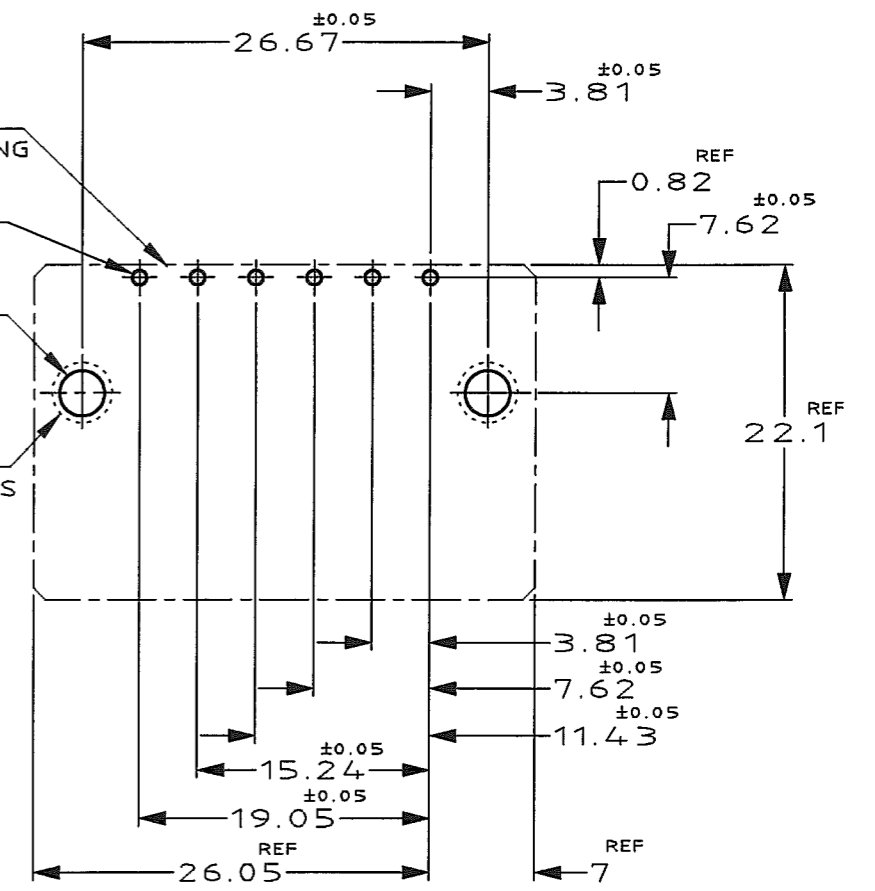
METRIC

DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST



- コネクタ外形
OUTLINE OF HEADER HOUSING
- ±0.1
6-φ1.1
DIA 1.1±0.1 5 PLACES
 - ±0.1
スルーホール 2-φ3
DIA 3±0.1 2 PLACES
 - ラウンド 2-φ4 MIN
ROUND DIA 4 MIN 2 PLACES



推奨基板取付け穴寸法
PC 基板厚: 1.6±0.1
(非累積公差)
(コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN
PC BOARD THICKNESS: 1.6±0.1
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
(CONNECTOR MOUNT SIDE)

NOTES

- MATERIAL: HOUSING: GLASS FILLED THERMO PLASTIC, POLYESTER
CONTACT: COPPER ALLOY
RETENTION LEG: COPPER ALLOY
- FINISH (CONTACT AREA): 0.38μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- FINISH (CONTACT AREA): 0.76μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
- FINISH (RETENTION LEG): TIN LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
- FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL

注記

- 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性
ポリエステル樹脂
コンタクト: 銅合金
リテンションレグ: 銅合金
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.38μm MIN金めっき
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.76μm MIN金めっき
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 2.0 μm MINスズめっき
- めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
ニッケル下地の上に半田めっき
- めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
ニッケル下地の上にスズめっき

△6	△4	1,2-178296-5
△6	△3	1,2-178296-3
△6	△2	1,2-178296-2
(FINISH)		製品番号 (PART NO.)

B	REVISED(FJD0-0039-03)	TS	SM	25.APR '03
A	REVISED(FJD0-0114-03)	TS	SM	1-10 '95
0	RELEASED	KI	SM	
LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE

Copyright © 1994 AMP(Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED.	
WIRE RANGE mm ² (AWG -)	INSULATION DIA mmφ
MATERIAL SEE NOTE 注記参照	FINISH SEE NOTE 注記参照
DR. 22/DEC/94 K.IKEDA	DE. 22/DEC/94 K.IKEDA
CHK. 10/JAN/95 S.MANABE	APP. 10/JAN/95 S.MANABE

Copyright © 1994 AMP(Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED.			Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan		
NAME ダイナミック 3100 シリーズ 6 極 ヘッダーアセンブリー (水平タイプ) 6 POS SINGLE ROW HORIZONTAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC 3100					
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)			SIZE	LOC	NUMBER
10mmF : ±0.3	10mmE 30mmF : ±0.4	30mmE 100mmF : ±0.5	B	J	C-178296
SCALE 2-1			REV. B	SHEET 1 OF 1	